

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2005 年 6 月 23 日 (23.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/056676 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: C08L 63/00
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/018144
- (22) 国際出願日: 2004 年 12 月 6 日 (06.12.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2003-413229  
2003 年 12 月 11 日 (11.12.2003) JP  
特願 2004-260963 2004 年 9 月 8 日 (08.09.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.)  
[JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 天童 一良 (TEN-DOU, Kazuyoshi). 片寄 光雄 (KATAYOSE, Mitsuo).
- (74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒1050001 東京都港区虎ノ門 1 丁目 2 番 3 号 虎ノ門第 1 ビル 9 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: EPOXY RESIN MOLDING MATERIAL FOR SEALING AND ELECTRONIC COMPONENT

(54) 発明の名称: 封止用エポキシ樹脂成形材料および電子部品装置

(57) Abstract: Disclosed is an epoxy resin molding material for sealing which contains an epoxy resin, an epoxy resin curing agent, and a pitch. Also disclosed is an electronic component which comprises a device sealed with such a molding material. This molding material is good in coloring properties. Furthermore, even when this molding material is used for a package wherein distances between pads or wires are small, short-circuit defects due to conductive materials can be prevented since this molding material contains no conductive carbon black.

(57) 要約: エポキシ樹脂、エポキシ樹脂硬化剤、およびピッチを含有する封止用エポキシ樹脂成形材料、ならびに、この成形材料で封止された素子を備えた電子部品装置を開示する。この成形材料は、着色性が良好であるとともに、パッド間やワイヤー間距離が狭いパッケージに用いた場合でも、導電性物質であるカーボンブラックを含まないので、導電性物質に起因するショート不良を防止することができる。

WO 2005/056676 A1